カルコパイライト型半導体 AgGaSe2の組成依存性

松尾 整¹⁾・吉野 賢二²⁾・碇 哲雄³⁾

Dependence of Composition on Chalcopyrite Semiconductor AgGaSe₂ Thin Film

Hitoshi Matsuo, Kenji Yoshino, Tetsuo Ikari

Abstract

AgGaSe₂ thin film was deposited on glass substrates by vacuum evaporation method. The starting material was mixed Ag₂Se and Ga₂Se₃ powders. Ag/Ga ratios were 1.5, 1.2, 1.0, 0.8, 0.7 and 0.4. The samples were annealed from 100 to 600 °C for 10 min. After these processes, single phase AgGaSe₂ thin films could be obtained except Ag/Ga ratio of 0.4 at annealing temperature of 600 °C. Ag-rich samples had large grain. On the other hand, Ga-rich samples had small grain. Furthermore, Ga-rich and Ag-rich samples indicated p-type and n-type because of Ag vacancy and Se vacancy, respectively.

Key Words:

chalcopyrite, AgGaSe₂, thin film, evaporation

1. はじめに

カルコパイライト型半導体は、直接遷移半導体であ るため光吸収特性に優れており、光劣化が起こりにく く耐放射性が高いことから、宇宙用太陽電池としても 期待されている。またカルコパイライト型半導体の禁 制帯幅は CuAIS₂の 3.5 eV から、CuInTe₂の 0.8 eV と幅 広い波長をカバーしており赤外域から紫外域までの発 光、受光作成が可能である¹⁻²⁾。実際に、多結晶 CuInGaSe₂太陽電池において変換効率が 19.5 %という 報告もある³⁾。バンドギャップ 1.8 eV をもつ AgGaSe₂ は、赤外出力の有効な周波数低倍素子として証明され ている。しかしながら非線形光学素子としての解明は 進んでいるが、薄膜太陽電池等の半導体としての物性 解明は進んでいない。

- 1 電気電子工学専攻大学院生
- 2 電気電子工学科助教授
- 3 電気電子工学科教授

また最高の変換効率を誇る多結晶 CuInGaSe₂太陽電 池は禁制帯幅約 1.1 eV あたりの禁制帯幅で作製される ためこれ以上の高効率化を目指すうえではヘテロ構造 をとることが必要となる。そこで禁制帯幅 1.8 eV 付近 をもつ材料とタンデム構造(短波長側のトップセル)を 作ることによって、変換効率の向上が期待できる。 AgGaSe₂はバルク成長としてはブリッジマン法⁴⁾によ る報告がされており、薄膜に関しては MBE 法やフラ ッシュ蒸着法⁵⁻⁶⁾による報告がされている。また太陽電 池としては p-AgGaSe₂/n-CdS 太陽電池で変換効率は 4.5%⁷⁾を達成している。また Ag, Ga, Se の組成比を変え た文献は、ほとんどない。

そこで今回、太陽電池作製のための最適条件をさが すことを目的に AgGaSe2薄膜を試料は真空蒸着法を用 いて作成を行った。装置としては最も簡単で低コスト で、短時間成長が期待できる。

2. 実験方法

本研究では、粉末二元系材料 Ag₂Se (99.999 %、フ ルウチ化学株式会社) Ga₂Se₃(99.999 %、フルウチ化学 株式会社)を用いて式(1)となるように、Ag と Ga 比が 1.5、1.2、1.0 (stoichiometry)、0.8、0.7 となるよう に混合し、真空蒸着法にて室温で AgGaSe₂薄膜を作成 し Ar 雰囲気中で 100~600 °C、10 分間熱処理を行った。

 $Ag_2Se + Ga_2Se_3 \rightarrow 2AgGaSe_2$ (1) 作成したサンプルを X 線回折(XRD)測定法によって 物質同定、格子定数、粒界サイズを、Electron micro probe Analysis(EPMA)により組成分析を行い、触針計 により表面状態の観察を行い、透過率反射率測定によ って吸収係数と禁制帯幅を、ホール測定により抵抗率 を測定し評価した。

XRD 測定では、加速電圧 40 kV、管電流を 80 mA と設定し、ターゲットとしては Cu を用い、K_a線 (λ =1.5405 Å)を用いた。強度の強い K_al線を光源とし て、K_a2線は解析の段階で除去した。今回測定したカ ルコパイライト半導体 AgGaSe₂ の結晶は正方晶であ るので面間隔 d と面指数(hkl)、格子定数は以下のよう になる。

$$\frac{1}{d^2} = \frac{h^2 + k^2}{a^2} + \frac{l^2}{c^2}$$
(2)

また結晶の粒の大きさを示す結晶粒界サイズ t は、 測定によって求めた半値幅 B (rad)、入射波の波長 λ (λ = 1.54050 Å) 、反射角 θ (rad)との関係から以下のよ うな式で表される。

$$t = \frac{0.9 \bullet \lambda}{B \bullet \cos \theta} \tag{3}$$

(3)式はシェラー (Scherrer) の式と呼ばれる。

触針計は近接する二つの物質間には互いに力が作 用しあうので、観察試料に対して触針計の制限は存在 せず、電気導電性に乏しい試料に関しても観察可能で あるという特徴を持つ。また試料雰囲気についても制 限が少なく液体中や真空中のいずれでも動作可能で ある。このため、単に表面物理・化学の分野だけでな く、半導体、有機材料、生体関連試料、磁性体などさ まざまな材料の微視的観察・評価に用いられている。 本研究では触針計(セイコーインスツルメンツ社 Nanopics 1000)を用いて表面状態の観察を行った。

光が物質中を通過する割合は、反射と物質内での吸 収に依存する。ある波長に対して、吸収率A、反射率 R、透過率Tとすると

$$T = (1-R)^2 exp(-A)$$
(4)

という関係が成り立つ。

吸収率は試料厚さをx、吸収係数をαとすると

$$A = \alpha x \tag{5}$$

であらわせる。これを(4)式に代入して、吸収係数αに ついて解くと

$$\alpha = -\ln\left[\frac{(1-R)^2}{T}\right]/x \tag{6}$$

さらに禁制帯幅 *Eg* は光速 *c*、プランク定数 *h* (*h*=6.62607×10³⁴ J・s)として以下のように表される。

$$c(hv-Eg) = (\alpha hv)^{2} = \left(\frac{\ln\left[\frac{(1-R)^{2}}{T}\right] \cdot hv}{x}\right)^{2}$$
(7)

以上のよう、透過率と反射率を求めることによって禁 制帯幅と吸収係数を算出することが可能である⁸⁻⁹⁾。

電気的評価として四端針法による抵抗率測定と伝 導型の判定のためサーモプローブ分析を行った。

EPMA 分析により Ag、Ga、Se の組成分析の測定を 行った。

3. 実験結果

3.1 真空蒸着法

真空蒸着したサンプルを Ar ガス雰囲気中で 100 ℃ から 600 ℃ までの温度にて熱処理を行った。熱処理 温度が高くするにつれて、表面は光沢のある黒い銀色 から鈍く光る銀色と変化した。Ag/Ga比が高い Ag-rich の試料では Ag/Ga 比が大きくなるにしたがって、銀



Fig. 2 X-ray diffraction patterns of AgGaSe₂ thin film grown by evaporation method.

色が濃くなった。また Ag/Ga 比が小さくなると、黄 色っぽい銀色から暗い橙色と変化した。

3.2 X線回折

Fig. 1にArガス雰囲気での熱処理の化学量論的組 成比 (Ag/Ga=1.0) の X 線回折スペクトルを示す。さ らに Fig. 2 に熱処理温度 600 °C で熱処理した組成変 化(Ag/Ga=0.4 ~1.5)サンプルの X 線回折スペクトル を示す。それらの図中に JCPDS[AgGaSe2(No. 311240)]、 JCPDS [Ag (No. 411402)] & JCPDS [Ga₂Se₃ (No. 50724)] と JCPDS[Ag₂Se (No. 241041)]も同時に示す。熱処理な しから 300 °Cにおいて, 主に Ag ピークと Ga₂Se₃ ピー クが検出された。これは蒸着した段階では Ag や Ga₂Se₃といった物質が積層した形で存在し、反応せず に残ったと考えられる。熱処理温度 400 ℃ 以上で AgGaSe2相以外の異相を含んだ状態ではあるが、 AgGaSe2も検出された。これは熱処理により熱エネル ギーを受けて、AgやGa₂Se₃といった低温の熱処理で みられた積層していた物質が高温度のよって固層成 長したと考えられる。さらに、600 ℃では、AgGaSe2 単相が得られた。

Fig. 2の結果より Ag/Ga 比0.4以外はすべて AgGaSe2



Fig. 2 X-ray diffraction patterns of various Ag/Ga ratios at annealing temperature of 600 °C.

単相が検出された。これは熱処理温度600 °C という 温度で AgGaSe₂が育成されること、また組成が大幅に ずれてもカルコパイライト型構造を維持しているこ とを意味している。これは、ずれた組成が異相を形成 することなく、点欠陥として存在していると考えられ る。また JCPDS と比較して(112)に対して非常に強い 配向性を示した。この(112)面の配向はその他の Cu 系 の薄膜でも同様の報告がされており良質の結晶であ るとされている¹⁰⁾。特に Ag/Ga 比0.8は最も強い配向 性を示している。したがって作製した AgGaSe₂薄膜は



Fig. 3 Relationship between Ag/Ga composition and lattice constants at annealing temperature of 600 °C.

どれも良質の結晶が得られており、特に Ag/Ga 比0.8 が最もよいと考えられる。

ストイキオメトリーの試料の熱処理温度依存性 では熱処理温度大きくするにしたがって JCPDS に近 づく結果が得られている。Fig. 3 に X 線回折ピーク 位置から式 (2)を使って求めた格子定数の図を示す。 参考として AgGaSe₂のデータ(*a*=5.993, *c*=10.8840Å) も示す。*a*軸はほぼ JCPDS と一致した。しかし*c*軸 は若干低い値が得られた。これは AgInSe₂を同様の方 法で作製した際も同じ傾向が得られていることから この作製法特有の現象であると考えられる¹¹⁾。また、 *c*軸に関して Ag/Ga 比1.0や0.8がもっとも近い値が得 られており組成がずれるにしたがって *c*軸との差は 大きくなることから、結晶に格子欠陥によってひずみ が発生していると考えられる。

3.3 触針計

ストイキオメトリーの試料での熱処理温度依存性 では、熱処理温度増加とともに大きな粒界が得られた。 これは熱処理温度の増加とともに AgGaSe₂ の結晶成

 $\begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ 1 \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\ \mu m \end{bmatrix}^{2} \\ 1 \\ \begin{bmatrix} \left(a \right)^{2} \\ 1 \\$

(c)

 $1 \, \mu m$

長が起こり、この結晶成長ともに粒界も大きくなった と考えられる。

Fig. 4 に熱処理温度 600 °C の Ag/Ga 比 0.7 と Ag/Ga 比1.5のサンプルの触針計により表面状態を観察した 結果を示す。(a)、(c)が試料表面を見たものでサイズ としては縦4 µm、横4 µm である。また、(b)、(d)が 断面の像を示す。図中にスケールをそれぞれ示した。 ここでは、Ag/Ga 比 0.7 を Ga-rich サンプル、Ag/Ga 比1.5をAg-rich サンプルとする。Ag-rich サンプルで は、全体的に平坦な表面で、粒界は大きなものが得ら れた。一方 Ga-rich サンプルは凸凹とした表面が観察 され、粒界は小さなものが得られた。Fig. 5 に式(3) のシェラーの式より求めた粒界計算結果を示す。この シェラーの式によって求められた粒界は Ag/Ga 比の 増加とともに大きくなる傾向にあった。触針計で得ら れた Ag-rich は大きな粒界であり、Ga-rich サンプルで は小さな粒界である傾向と、ほぼ一致している。しか しながら高効率太陽電池で報告されている粒界は0.5 ~1 µm¹²⁾であり、得られた試料のサイズは小さい値で あった。



Fig. 4 Surface morphology and cross sections in the Ag/Ga ratio of 0.7 (a, b) and 1.5 (c, d).



Fig. 5 Relationship between grain sizes and Ag/Ga ratio on AgGaSe₂ thin films.

3.4 光学的測定

ストイキオメトリーの試料での熱処理温度依存性 では温度増加とともに、はっきりした基礎吸収端が確 認できた。これは、XRD スペクトルによって確認さ れた結晶成長や AgGaSe2 層の成長によるものと考え られる。Fig.6に透過率スペクトルの組成変化、熱処 理温度 600 °C での結果を示す。組成変化の透過率ス ペクトルは、Ag/Ga比 1.5 以外ではっきりとしたバン ド端が得られた。これは単相が得られた試料と一致す る結果である。組成変化では Ag-rich サンプルと Ga-rich サンプルでは大きな違いがみられた。Ga-rich サンプルでは、高透過率となり、Ag-rich サンプルは 低透過率となった。これは、Ag-rich サンプルでは光 沢のある表面であることから低透過率となったと考 えられる。実際反射率が Ga-rich サンプルに比べて Ag-rich サンプルは大きくなっている。またひとつに は触針計で観察した表面状態が関係あると考えられ る。しかしながらこの表面状態と透過率との関係はは っきりしてはいない。また、透過スペクトルには、干 渉と思われる波のようなスペクトルが観察された。こ れは AgGaSe2 薄膜が、高品質であることを示してい る。



Fig. 6 Transmittance spectra at RT of AgGaSe₂ thin films in various compositions at annealing temperature of 600 $^{\circ}$ C

Fig. 7に透過率測定と反射率測定から(7)式を使って 求めたバンドギャップと組成依存との関係の図を示 す。膜厚は1.5 µmで SEM の断面によって得られた。 Ag/Ga 比1.5は明確なバンド端が確認できなかったた め計算できてはいない。計算結果より1.77~1.79 eV のバンドギャップが得られた。銀の組成が多くなると、 バンドギャップは若干高くなる。これは銀の組成を多 くすると熱処理温度が低温で抵抗率が低くなること



Fig. 7 Relationship between bandgap energy and Ag/Ga ratio on AgGaSe₂ thin Films.

からキャリア濃度の増加が考えられる。このキャリア が光を吸収し、光学的なバンドギャップが変化したと 考えられる。どの値もそのほかで報告されている文献 値^{5,6,13-15)}とほぼ一致している。

3.5 電気的測定

Fig. 8 に四端針法にて測定した抵抗率の熱処理温度 依存と組成変化のグラフを示す。なお、Ga-rich サン プルとなる Ag/Ga = 0.4~0.8 についてはどの熱処理温 度でも高抵抗となり測定できなかった。四端針法の本 装置の測定不能高抵抗域は $10^6 \Omega/\Box$ 以上である。また 図中 Over load とは高抵抗で測定不能であったことを 示す。

温度依存性について、どのサンプル(Ag/Ga = 1.0, 1.2, 1.5)も熱処理温度400 °C までは抵抗率は減少傾向 であった。また AgGaSe₂相の結晶成長が X 線回折に よって確認された400 °C 以上の熱処理温度では抵抗 率は上昇傾向であった。これは熱処理温度400 °C ま では積層した各元素が熱エネルギーよってしだいに 結晶化したと考えられる。また400 °C 以上の熱処理 温度で抵抗率が上昇したことについては AgGaSe₂相 の成長によるものと考えられる。AgGaSe₂は非常に高



Fig. 8 Dependence of electrical resistivity as a function of annealing temperature on AgGaSe₂ thin films at annealing temperature of 600 °C.

抵抗で半絶縁物とする文献¹⁶⁾もある。熱処理温度によ って抵抗率が変化するのは、残った異相が電気伝導の パスをつくり、このパスにキャリアが流れるため抵抗 が低くなったと考えられる。このため熱処理温度に依 存するように抵抗率は上昇している。

また Ag/Ga 比の増加、つまり銀組成が増加すると ともに抵抗率の減少がみられた。特に Ag/Ga 比 1.5 において劇的な抵抗率の減少が確認された。これは過 剰な銀組成がキャリアのパスをつくり抵抗率が減少 したと考えられる。

3.6 EPMA 測定

Fig. 9 に熱処理温度 600 °C での EPMA 測定結果を 示す。プロット点は測定結果を示し、実線は蒸着開始 前の原料比率を示した。

EPMA 結果からすべてのサンプルで Se-poor となっ た。これは、Se は一般的に蒸気圧が高いので、熱処 理によって抜けたと考えられる。Ga-rich サンプル (Ag/Ga 比<1)では、Ag-poor, Se-poor であり、Ga-rich であった。またこれらのサンプルは P 型であった。 一方、Ag-rich サンプル(Ag/Ga 比>=1)では、Se-poor, Ga-poor、Ag-rich であった。またこれらの伝導型は N



Fig. 9 Relationship between EPMA results and Ag/Ga ratio on AgGaSe₂ thin films at annealing temperature of 600 °C.

型であった。

以上の結果から、N型伝導に起因している点欠陥と しては Se 空孔(V_{Se})が考えられる。これはそのほかの CuInSe₂についても同様の報告があり、また Nigge ら も N型の起源として Se 空孔をあげている¹⁷⁾。一方 P 型伝導に起因する点欠陥については EPMA 測定の結 果から銀空孔(V_{Ag})と Se サイト Ga(Ga_{Se})考えられる。 同じくカルコパイライト系の Cu 系では、Zunger らの 第 I 原理計算から I 族空孔の V_{Cu}が P型の起源として は最も生成しやすいという報告があり¹⁸⁾、また Nigge らがフォトルミネッセンス測定によって P 型の起源 はカチオン空孔(V_{cat})と報告していることから、P 型電 導に起因する点欠陥は、V_{Ag} と考えられる。

4. 結論

二元系材料である Ag₂Se と Ga₂Se₃を、Ag/Ga=0.4~ 1.5 まで蒸着源の組成を変えることによって真空蒸着 法にて AgGaSe₂ 薄膜を室温でガラス基板上に作製し た。このサンプルを Ar ガス雰囲気にて 100 ~600 ℃ での温度で熱処理を行った。

熱処理温度変化では、熱処理温度 600 °C にて AgGaSe₂単相の育成に成功した。さらに、組成変化で も Ag/Ga 比 0.4 以外で単相を確認できた。これらの膜 は AgGaSe₂の JCPDS と比較すると(112)に配向し、特 に Ag/Ga 比 0.8 がもっとも配向が強かった。ピーク位 置から格子定数を計算したところ熱処理温度を高く するにしたがって JCPDS 値と近づき、600 °C のとき がもっとも近づく結果となった。この組成変化では a軸は JCPDS 値とほぼ一致し、c 軸では化学量論的組 成比のときが最も近い値であった。

触針計で観察した表面状態では、Ag-rich サンプル では平坦な表面に大きな粒界が観察された。一方 Ga-rich サンプルではシャープな表面状態で小さな粒 界であった。 透過率測定ではAg/Ga比 1.5 以外ではっきりとした基礎吸収端が観測され、干渉も見られた。光学的なバンドギャップを計算したところ、1.77~1.79 eV であった。これは報告されている AgGaSe₂ のバンドギャップと一致する結果であった。

電気的測定では Ag-rich は低抵抗となったが Ga-rich サンプルでは高抵抗であった。EPMA 測定の 結果から Ga-rich サンプルでは Ag-poor、Se-poor、 Ga-rich で、Ag-rich サンプルでは Ga-poor、Se-poor、 Ag-rich であった。また Ag-rich サンプルでは N 型、 Ga-rich サンプルでは P 型であった。伝導型に起因し ている点欠陥として、N 型が Se 空孔、P 型が Ag 空孔 であると考えられる。さらに、N 型のキャリアが P 型のキャリアと補償しているとみられ、このため高抵 抗となったと考えられる。

引用文献

- 三宅 秀人,杉山 耕一:応用物理 65 (1996)
 173.
- B. M. Basol, A. Halani, C. Leidholm, G. Norsworthy,
 V. K. Kapur, A. Swartzlander and R. Matson: Prog. Photov. Res. Appl. 8 (2000) 227.
- M. A. Contreras, K. Ramanathan, J. AbuShama, F. Hasoon, J. Keane, D. L. Young, B. Egaas and R. Noufi: Prog. Photov. Res. Appl. 13 (2005) 209.
- R. S. Feigelson and R. K. Route: J. Crystal Growth 104 (1990) 789.
- R. S. Feigelson and R. K. Route: J. Crystal Growth 104 (1990) 789.
- Y. S. Murthy, B. S. Naidu and P. J. Reddy: Vacuum
 41 (1990) 4.
- 7) S. M. Patel and V. G. Kapale: Mater. Lett. 4 (1986) 3.
- Y. S. Murthy, O. M. Hussain, B. S. Naidu and P. J. Reddy: Mater. Lett. 10-12 (1991) 504.

- 9) 吉田 貞史: 薄膜 (培風館, 1999).
- 小長井 誠:薄膜太陽電池の基礎と応用(オーム 社,2001).
- H. Matsuo, K. Yoshino, T. Ikari and T. Nakada: Ex. Abstract, PVSEC-15 (2005) 586.
- 12) T. Nakada, K. Yamada, R. Arai, H. Ishizaki and N. Yamada: Proc. 20th European Phovoltaic Solar energy Conference and Exhibition (2006) (印刷中).
- 13) S. R. Hahn and W. T. Kim: Phys. Rev. 27 (1983) 8.
- 14) S. M. Patel and V. G. Kapal: Thin Solid Films 148 (1987) 143.

- T. S. Murty, S. Uthanna, B. S. Naidu and P. J. Reddy: Solid State Comm. **179** (1991) 227.
- 16) B. Tell and H. M. kasper: Phys. Rev. B 4 (1971) 4455.
- K. M. Nigge. F. P. Baumgartner and E. Bucher: Sol. Energy Mater. and Sol. Cell 43 (1996) 335.
- A. Zunger, S. B. Zhang and S-H Wei: Proc. 26th IEEE Photovoltaic Specialists Conf. (1997) 313.